

乙烯基硅树脂 RH-S605-3

主要组份

甲基乙烯基 MQ 硅树脂与乙烯基封端聚二甲基硅氧烷混合物

性能指标

外观	淡黄色透明液体
M/Q 比	0.8 左右
树脂含量	70%
粘度 (25℃, mpa.s)	80000-100000
乙烯基含量 (wt%)	1.23-1.27
挥发份 (wt%)	≤1.0%

特性

本产品特性较脆硬, 固化过程中挥发份少, 不易产生气泡。与乙烯基硅油和含氢硅油调配, 可制成中低硬度的产品, 广泛用于电子灌封胶。适当添加于加成型硅橡胶配方中, 可提高其硬度, 撕裂强度等。具有耐高温、电气绝缘、防潮、防水等优良性能。可溶入低粘度的乙烯基硅油、甲苯、120#汽油等。

用途

- 1 表面处理剂: 如用于有机硅压敏胶、手机按键、环氧类粘接剂粘接表面等;
- 2 补强填料: 可用于 RTV 胶、HTV 胶、加成型液体硅橡胶、热硫化硅橡胶混炼胶、半导体元器件的无壳灌封;
- 3 增粘剂: 用于建筑密封胶、涂料、高温云母板及玻纤布层压板等理想的粘接剂;
- 4 其它添加剂: 配制脱膜剂、消泡剂、防粘剂及光亮剂、加成型防粘剂的剥离力调节剂等, 还可用作大理石、地板砖耐磨、抛光处理。

贮存

防止日光直照暴晒, 远离明火, 保持通风干燥。贮存期 2 年。

特别说明

本文所提供的技术参数均为典型值, 仅供参考, 不作为产品验收标准, 恕不经预告更改。由于使用条件的差异, 我们不能保证产品在某些用法与用途上的正确性和适用性, 不承担由此产生的任何直接、间接或意外损失责任。用户在使用产品之前应进行相关试验或咨询我司技术人员。